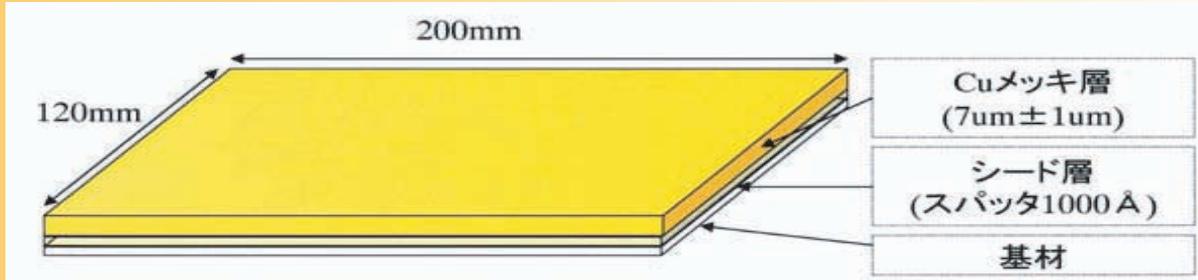


銅 (Cu) 電鍍

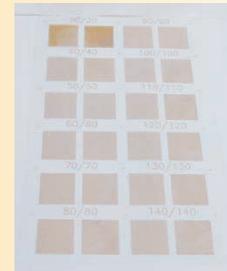
均一に厚みをつけることができる電鍍技術の特徴を活かして通常のCu電気メッキではできない均一なCuメッキ層を形成することができる。(通常では周辺部分が厚く真中が薄く積層される)



シード層成膜後

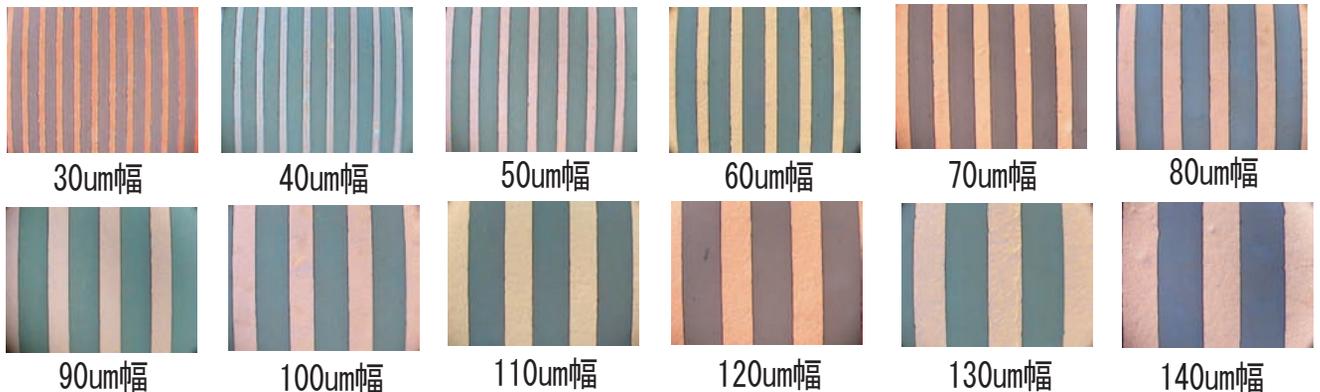


Cuメッキ層成膜後



パターンエッチング後

パターンエッチング後の拡大写真



Cuメッキ層、シード層をパターンエッチングすることにより微細回路形成が可能
 厚みが均一なので熱を一定に伝えないといけないアプリケーション等に適用が可能

銅電鍍仕様



φ160mm 300μm銅電鍍板

現在対応可能な銅電鍍装置は自動処理対応ではないので1枚ずつの電鍍処理となります。よって銅電鍍枚数が多くなればある程度のお時間が必要ですのでご入用の際はなるべく早めにご依頼下さいませ。

対応基材材質：SUS、樹脂等

対応基材サイズ：φ200mm以下（外周部から10mmは析出しない）

銅積層厚み：数μm～数百μm